

Mikroätze

SLOTETCH 584

Die Mikroätze SLOTETCH 584 wurde speziell für die Vorbehandlung von Leiterplatten, IC-Trägern, Kupfer und Alloy 42 (Nickel/Eisen) Grundmaterial entwickelt.

SLOTETCH 584 kann sowohl bei der Durchkontaktierung sowie in allen Stadien des Leiterbildaufbaus angewendet werden.

Das Produkt:

- sorgt für eine gleichbleibende Ätzrate,
- besitzt eine lange Standzeit,
- ist einfach in der Wartung,
- und wirtschaftlich in der Anwendung.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

